

集成电路刻蚀设备用硅材料项目招标计划

(招标编号：/)

一、内容：

项目名称：集成电路刻蚀设备用硅材料项目

招标人名称：山东有研半导体材料有限公司

估算投资：7500 万元

预计招标时间：2023 年 5 月 26 日

项目概况：本项目位于山东省德州市天衢开发区尚德七大道以南、尚德八大道以北、崇德八大道以东、崇德十大道以西。

招标内容：集成电路刻蚀设备用硅材料项目生产厂房，占地面积 13440m²单层钢结构厂房，局部二层办公室；以及厂房周边道路、地下管网、绿化等内容。具体以招标公告、招标文件为准。

重要提示：本次公开的招标计划（意向公示）是项目的初步安排，具体情况以招标公告和招标文件为准。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为山东有研半导体材料有限公司。

三、联系方式

招 标 人：山东有研半导体材料有限公司

地 址：山东省德州市德城区尚德 8 路 3998 号

联 系 人：马云忠

电 话：0534-8051388

电子邮件：/

招标代理机构：中国城市发展规划设计咨询有限公司

地 址：/

联 系 人：/

电 话：/

电子邮件：/



